

【原因・判断ポイント・発生工程】現像工程で DFR の剥離片が板面に再付着して、E T レジストとなったことにより出来たもの（現像～E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】在显影工序，DFR 剥離片再次附着在板面，成为 ET 剂而引起的（显影～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
A piece of peeled dry film is attached again to the base material and acts as an etching resist. (Developing - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×

1-5-1-4 ヘドロ突起／粘性汚泥の凸出 / Projected conductor by sludge

【特徴】回路導体と同一面のシャープな丸みを持った突起、形状はまちまちである

【特征】在线路面有轮廓清晰的圓角的凸出, 形状各异。

【Characteristics】A well defined and rounded projection of the same thickness as that of the conductor. Shapes vary.

【原因・判断ポイント・発生工程】回路導体となる銅めっき面に、ヘドロが付着し、これが E T レジストとなった為にできたもの（現像～E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】在导线的镀铜面附着粘性汚泥，成为 ET 剂而引起的（显影～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
Sludge attached on the plated copper surface acts as an etching resist and causes the defect. (Developing - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×